

產發署公私(產學)共育國內外高階人才計畫 113 年度第一梯次技術審查入選名單(1 月)

正取班級(15 班)			
領域	編號	開班單位	技術主題
客製化 諮詢	1	人上人企管顧問股份有限公司	IC 封裝與測試製程參數之大數據蒐集與分析
	2	社團法人台灣平坦化應用技術協會	單晶碳化矽切割加工技術
增值 研習	3	三建資訊有限公司	太赫茲 6G 新型光通訊前瞻技術動向
	4	三建資訊有限公司	積體化 2.5D/3D 發展趨勢及封裝、材料、冷卻技術的展望
	5	雷蒙德管理顧問有限公司	半導體製程與設備
	6	財團法人資訊工業策進會	THz Electronics for Sensing and Communication Applications
技術 研討	7	三建資訊有限公司	用於光電共封裝的內建矽光子封裝基板開發
	8	社團法人台灣電子設備協會	革新能源科技：深掘第三代化合物半導體 GaN、碳化矽材料功率元件的應用前景與寬頻隙技術突破國際論壇
潛力 學程	9	立新整合有限公司	高階封測技術潛力學程
	10	國立台灣大學	數位系統與架構設計潛力學程
	11	逢甲大學	半導體封裝測試實務潛力學程
	12	國立台北科技大學	智慧製造與低碳永續 AI 應用潛力學程潛力學程
	13	國立陽明交通大學	優質人才學程規劃_真藍芽耳機晶片與系統設計潛力學程
	14	國立陽明交通大學	電源 IC 產業碩士人才潛力學程
	15	國立陽明交通大學	數位類比電路設計潛力學程